

专利名称	专利号	授权日期	发明人	转让方式	受让方	转让金额(元)	转让收益(元)	现金奖励(元)	奖励人	所在单位	技术合同登记号
一种实现 3D 封装芯片互连的记忆焊点	ZL201510335335.3	2018/11/16	张亮; 孙磊; 郭永环	专利权转让	福建紫金英菲迅应用材料有限公司	20000	16000	15360	郭永环	机电工程学院	2023320307000086